

연수 제안서

연구 분야	열전 반도체 소재 신조성 개발
연구 과제명	능동 열제어 시스템을 위한 고성능 광대역 열전소재 개발
연수 제안 업무	열전 신소재 조성 개발 및 물성 분석
<div>(연수 내용)</div> <div>- 연수기간 : 2022.9.01. - 2024.12.31. (연장 가능)</div> <div>- 연수 내용 :<ul style="list-style-type: none">- 열전 반도체 소재 합성 및 신조성 탐색- 열전 물성 측정 (열전도도, 전기전도도, 제벡계수, zT 등)- 열전 소재 구조 분석 (XRD, SEM 등)- 열전 물성 측정 기술 개발- 열전 모듈 제작</div>	
소속 부 서 : 전자재료연구센터	

연수 책임자 : 백승협